

製品・技術 PR レポート

1. 企業概要

会社名	株式会社ナノプロセス			代表者名	刀原 寛孝		
				窓口担当	刀原 寛孝		
事業内容	レーザーによる受託加工と装置開発			URL	http://www.nanoprocess.jp/		
主要製品	各種材料に対するレーザー受託加工、レーザープロセス開発、レーザー装置販売等						
住所	〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町 1349						
電話/FAX 番号	053-482-1800/053-485-1512			E-mail	hiro@nanoprocess.jp		
資本金(百万円)	40	設立年月日	平成 19 年 4 月	売上(百万円)	60	従業員数	5

2. PR事項

『 レーザー微細加工、1個の試作からニーズに合わせた装置提供まで! 』

当社では、レーザー加工を核とし受託加工サービスを行っています。一般のレーザー加工業者では加工のみの対応というところがほとんどですが、1個の試作、個別対応、数量のあるリピート加工だけでなく、お客様の要求する仕様に合わせた装置の提供も可能です。装置化においてはグループ会社内(同敷地内)にて装置開発を設計、部品製作、組み立てまで一貫して行っています。

●当社の特徴

レーザー発振器メーカーでは、簡易試験はできても精度まで入れ込んだデバイスを仕上げるまでのテスト対応は不可能です。当社では必要であれば発振器、光学系を最適化して「加工装置」にて加工を行いますので装置導入に限らず試作においてもデバイス自身の性能評価まで行える加工が可能です。

●得意な加工

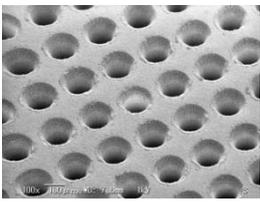
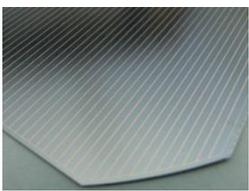
薄物材料に対する高品質加工

- ・各種セラミックス(サファイア、アルミナ、SiC 等)
- ・金属箔の高精度切り出し加工(～200 μ m)
- ・各種材料上の膜除去加工

●加工例

●常時利用可能な発振器等

超短パルス(ピコ秒)グリーンレーザー、Disk YAG レーザー、ファイバーレーザー(シングル/マルチ)、YVO4 グリーンレーザー、炭酸ガスレーザー(パルス/連続波)、YAG レーザー

窒化アルミへの穴加工	Si ウエハ上の SiO ₂ 薄膜除去加工	ポリイミドの切り出し加工
		
窒化珪素溝加工(深さ 0.4mm)	Ti(t100 μ m)の切り出し加工	サファイアへのマーキング加工
		

3. 特記事項(期待される応用分野等)

- 各種電子デバイス基板への加工、医療用分析機器への微細加工、セラミックスへの加工
- 主要取引先:セラミックスメーカー、電子基板メーカー、医療機器メーカー、自動車メーカー等の大手企業